

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

532

ML4

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

22.09.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
--------------	----------	----	--------	---------------

A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1	A00 B00
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	170		2	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		3	
A-RS-FR4-ML-0.20mm-035+035-TG150-HF	50200653	35	L2	4	
		200			
		35	L3		
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	170		5	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		6	
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	7	

Dicke nach Verpressen

B00: 690 µm Tol+: 80 µm Tol-: 80 µm Dmax: 770 µm Dmin: 610 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm Tol+: 0 µm Tol-: 0 µm Dmax: 0 µm Dmin: 0 µm

Kundenforderung

Dicke (D): 800 µm Tol+: 80 µm Tol-: 80 µm Dmax: 880 µm Dmin: 720 µm

Messstelle: (05) über LM und galv.Cu; beidseitig nominal: 680 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik